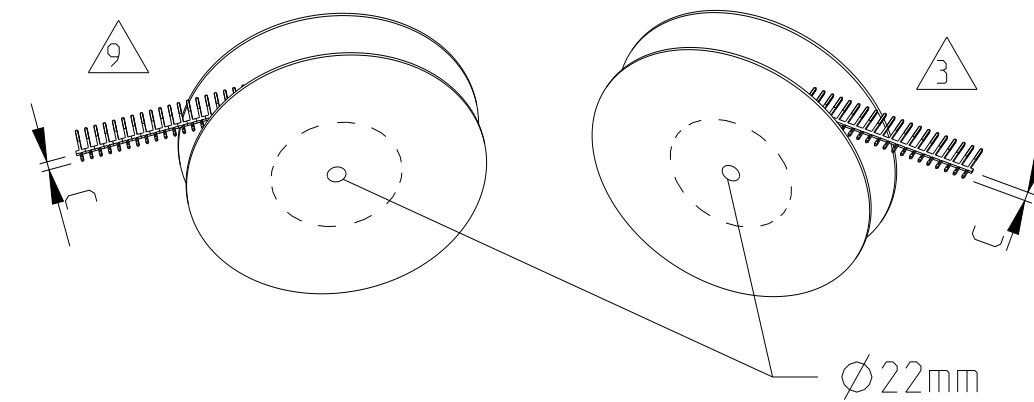
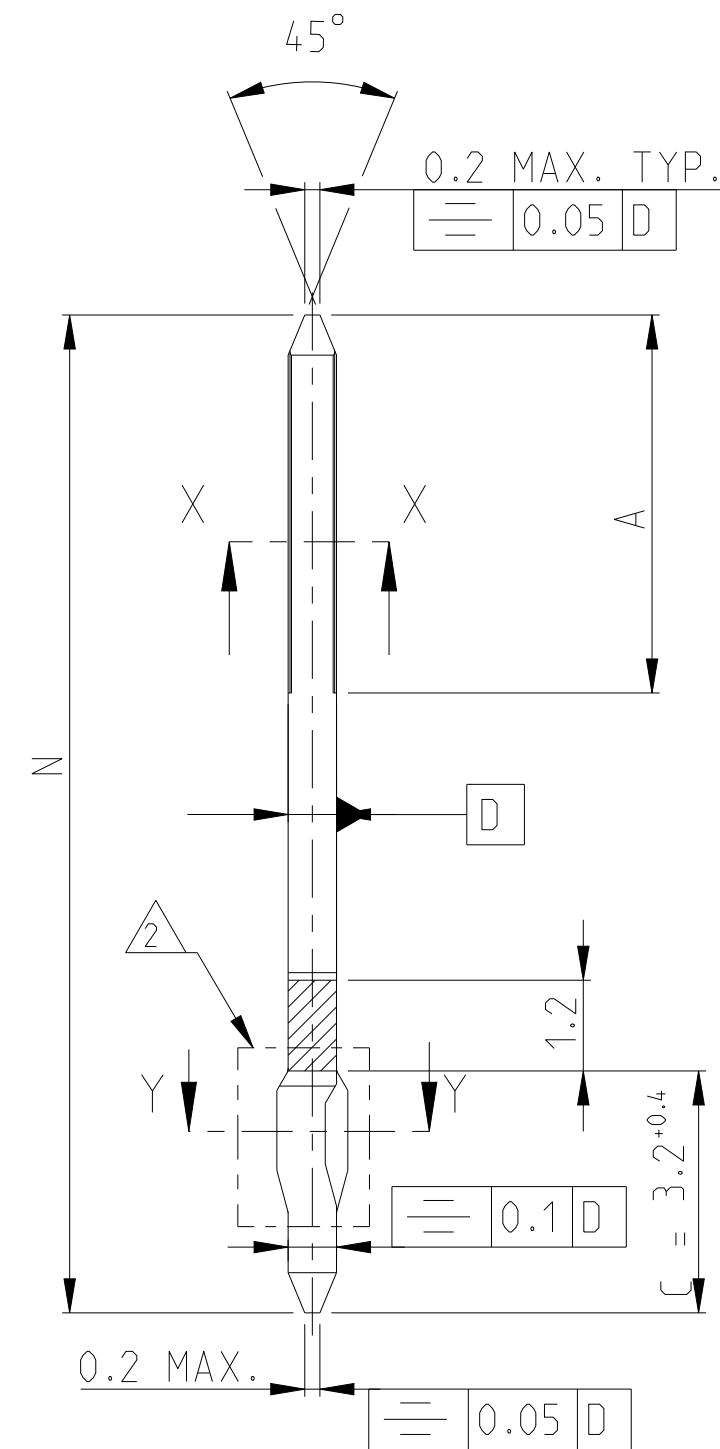
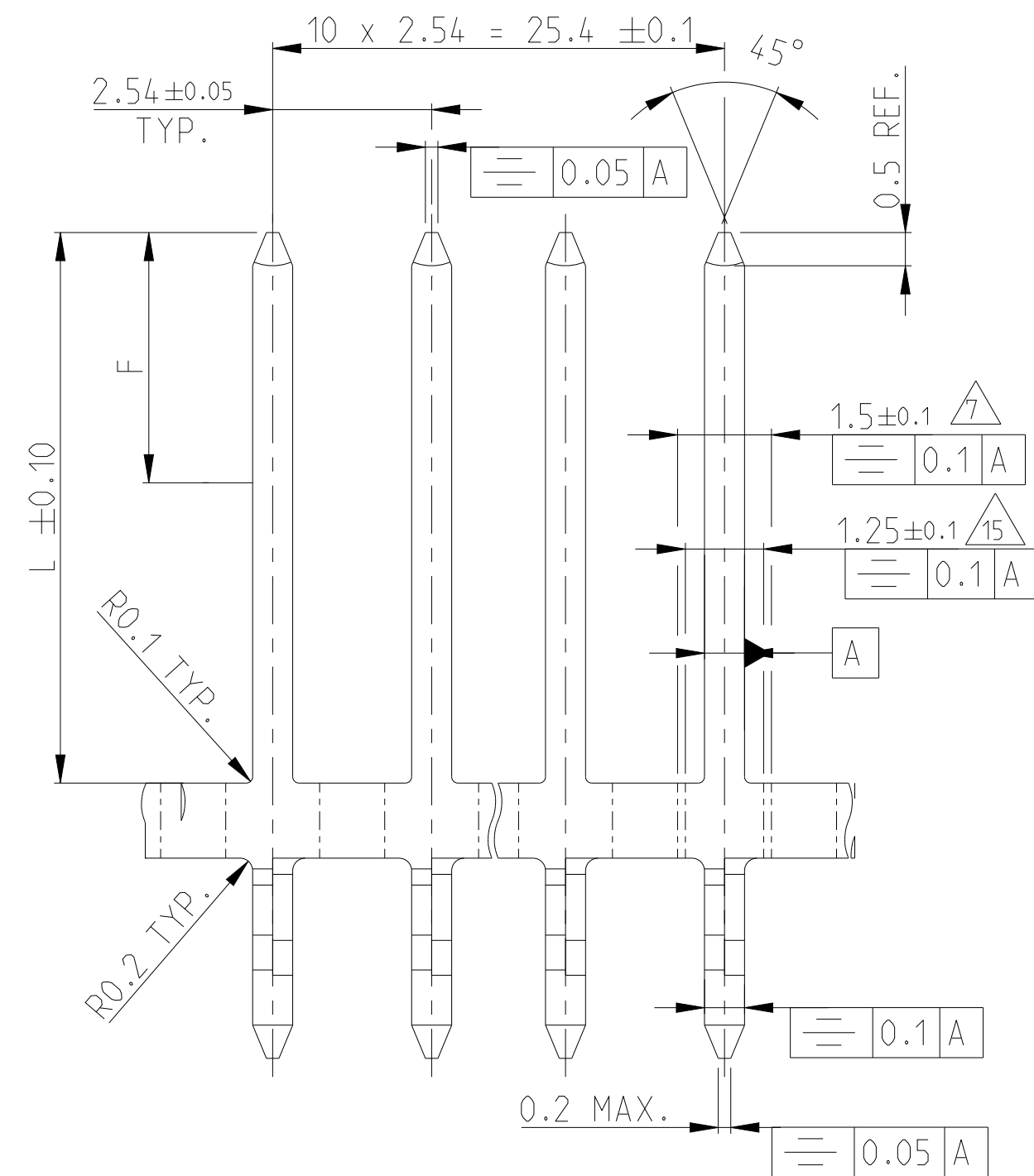
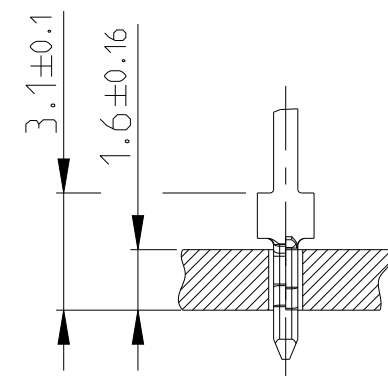
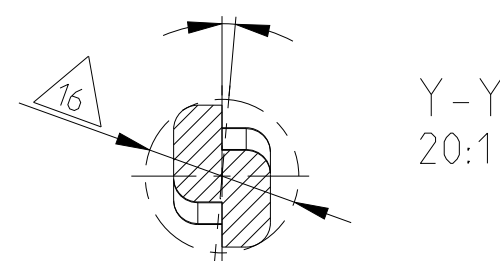


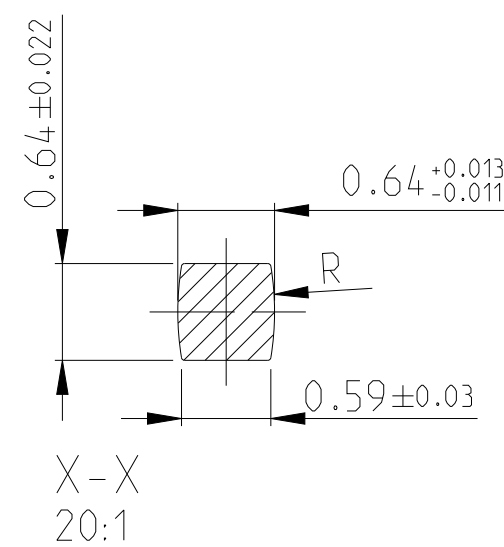
REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
	Y13	VALUES FOR DIM N ADDED IN TABLE	23SEP2021	SCB	KJK

[illegible]

ROTATION PERMITTED
VERDREHUNG ERLAUBT



ROUNDED AT AREA A
VERRUNDET IM BEREICH A



REFER SHEET 2 FOR NOTES

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 15JUN1986 A. HOFFMANN CHK 15JUN1986 M. SCHAARSCHMIDT APVD 15JUN1986 G. FELDMER		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± 3°		NAME AMPMODU II ACTION PIN FOR HOLE DIAMETER 0.9mm	
		PRODUCT SPEC 108-18012		APPLICATION SPEC -	
MATERIAL CuSn		FINISH SEE NOTES		SIZE A2	
		WEIGHT -		CAGE CODE 00779	
		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO C-928776	
		SCALE 10:1		SHEET 1 OF 2	
		REV Y13		RESTRICTED TO -	

4

3

2

I

© 2021 TE Connectivity. All Rights Reserved.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

NOTES:

1

AT AREA F MIN 0.8 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N;
AT AREA C 3.0 -6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

2

PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB
REQUIREMENTS FOR PCB HOLE

PLATED HOLE:
DRILL-Ø: 1.0 ±0.025
Cu-THICKN.: 25 - 50 µm
Sn-THICKN.: 4 - 10 µm
FINISHED HOLE-Ø: 0.9 ±0.07

UNPLATED HOLE:
DRILL-Ø: 1.0 ±0.025
FOR SOLDER APPLICATION

ALTERNATIVE-PLATING:
Cu-THICKN.: 25 - 50 µm
Ni-THICKN.: 1.3 - 5 µm
Au-THICKN.: 0.05 - 0.2 µm

93

REEL UNIT 50.000 PIECES. REEL-Ø 600mm / Ø588mm
REEL THICKNESS SEE TABLE

4

SOLDERABILITY ACC. TO IEC 60068 - 2 - 20; TEST Ta

5

AT AREA N 3.0-6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

6

AT AREA F 1-2 µm TIN; AT AREA C 3.0-6.0 µm TIN
OVER MIN 1.2 µm NICKEL

157

CUT AREA FOR LOOSE PIECE PARTS DURING THE STITCHING INTO PCB
DIMENSION IS DETERMINED BY THE TOOL OF THE STITCHING MACHINE

8

1000 PIECES ARE PACKED INTO SHOCK-PROOF BOX
AND CLOSED WITH COVER

10

AT AREA N MIN. 2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

12

AT AREA N 1-2 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

13

AT AREA F 2-4 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N;
AT AREA C MIN. 1.2 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

14

AT AREA F MIN 0.8 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N;
AT AREA C 1.3-2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

17

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

18

OBSOLETE

19

AT AREA F MIN. 1.2 µm GOLD OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N;
AT AREA C 1.3-2.5 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

20

AT AREA F 1.5-5.0 µm SILVER (WEIGHT% ≥98.0) OVER MIN 1.2 µm NICKEL AT AREA N
AT AREA C 3.0-6.0 µm TIN OVER MIN 1.2 µm NICKEL

21

PACKED ON PLASTIC REEL

22

PACKED ON CARDBOARD REEL

1

IM BEREICH F MIN. 0.8 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

2

EINPRESSZONE FÜR 1.6mm LEITERPLATTE
ANFORDERUNG AN DIE LEITERPLATTENBOHRUNG

PLATTIERTES LOCH:
BOHR-Ø: 1.0 ±0.025
Cu-DICKE: 25 - 50 µm
Sn-DICKE: 4 - 10 µm
FERTIGLOCH-Ø: 0.9 ±0.07

NICHT PLATTIERTES LOCH:
BOHR-Ø: 1.0 ±0.025
ZUM LÖTEN

ALTERNATIV-PLATING:
Cu-DICKE: 25 - 50 µm
Ni-DICKE: 1.3 - 5 µm
Au-DICKE: 0.05 - 0.2 µm

93

ROLLENEINHEIT 50.000 STIFTE. ROLLEN-Ø 600mm / Ø588mm
ROLLENDICKE SIEHE TABELLE

4

LÖTBARKEIT NACH IEC 60068 - 2 - 20; PRÜFUNG Ta

5

IM BEREICH N 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

6

IM BEREICH F 1-2 µm ZINN; IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN
ÜBER JE MIN. 1.2 µm NICKEL

157

SCHNITTSTELLE FÜR EINZELSTIFT BEIM EINSETZEN IN PCB
MAß IST DURCH WERKZEUG AN DER JEWELIGEN
EINSETZMASCHINE VORGEGEBEN

8

1000 STIFTE IN STOßSICHERE SCHACHTEL VERPACKT
UND MIT DECKEL VERSCHLOSSEN

10

IM BEREICH N MIN. 2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

12

IM BEREICH N 1-2 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

13

IM BEREICH F 2-4 µm ZINN ÜBER 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C MIN. 1.2 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

14

IM BEREICH F MIN. 0.8 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C 1.3-2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

17

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

18

OBSOLETE

19

IM BEREICH F MIN. 1.2 µm GOLD ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C 1.3-2.5 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

20

IM BEREICH F 1.5-5.0 µm SILBER (GEWICHT% ≥98.0) ÜBER MIN 1.2 µm NICKEL IM BEREICH N;
IM BEREICH C 3.0-6.0 µm ZINN ÜBER MIN. 1.2 µm NICKEL

21

VERPACKT AUF PLASTIKHASPEL

22

AUF KARTONROLLE VERPACKT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

MATERIAL
CuSn

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± 0.2
1 PLC ± 0.2
2 PLC ± 0.2
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ± 3°
FINISH

SEE NOTES

DWN
A.HOFFMANN
CHK
M.SCHAARSCHMIDT
APVD
G.FELDMEIER

15 JUN 1986
15 JUN 1986
15 JUN 1986

PRODUCT SPEC
108-18012
APPLICATION SPEC
-
WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
AMPMODU II ACTION PIN
FOR HOLE DIAMETER 0.9mm

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-928776

RESTRICTED TO
-

SCALE
10:1

SHEET
2 OF 2

REV
Y13

1471-9 (3/13)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-928776-7](#)